

ATM-8100X

全自動ウェーハマウンター Full-Automatic Wafer Mounter

【概要 - Outline -】

◆本装置はダイシング前工程として全自動で D/C フレームウェーハを真空チャンバー内でマウントする装置です。
The ideal system for mounting wafer in vacuum chamber to dicing frame automatically, before the dicing process.

【特長 - Features -】

- ◆プリカットテープ・ロールテープに対応。
Applicable pre-cut tape, non-precut tape. (Non-precut tape is option)
- ◆ウェーハマウント後の B/G テープ剥離機構を内蔵。
B/G tape removal function after mounting.
- ◆極薄ウェーハに対応。
Applicable ultra thin wafer.
- ◆オープンキャリア・プロトスからのウェーハ供給可能。
Wafer supply is available from open cassette, coinstack cassette.
(プロトス対応はオプション)
(Coinstack cassette is available as option)



仕様 Specification	ATM-8100X	
スループット Throughput	40 枚/h (B/G テープ剥離動作含む (但しテープの種類による)) B/Gtape removing (Depend on tape kinds)	
対応ウェーハサイズ Wafer Size	5・6・8 inch	
フレームサイズ Frame Size	2-6-1 / 2-8-1	
使用テープ幅 Tape Width	プリカットタイプ pre-cut tape	6 inch : W 230 mm / 8 inch : W 290 mm
	ノンプリカットタイプ non pre-cut tape	6 inch : W 230 mm / 8 inch : W 300 mm
ユーティリティ 電源 Power	AC200V 単相 Single phase 50/60Hz 6.0KVA	
Utilities 空気源 air	圧力 Pressure 0.4~0.5Mpa 300NI/min	
装置寸法 Demension	W 2,100 × D 1,800 × H 1,850 mm	
重量 Weight	950 kg (真空ポンプ含む) (including vacuum pump)	
オプション Option	B/G テープ用 UV 照射機・ID リーダーバーコードラベラー UV unit for B/G tape, ID reader barcode labeler	

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.